

<オンラインセミナー>

「進化する AI を支える熱設計 ~半導体の冷却技術と熱モデル~」

拝啓 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素は、当協会の諸事業に対しまして格別のご高配を賜わり厚く御礼申し上げます。

さて、半導体構造設計技術サブコミッティ (SC) では、半導体の熱設計手法として、半導体パッケージの熱モデルの標準化及び熱モデルに使用する熱伝導率測定に関する活動を進めております。

今般、「進化する AI を支える熱設計 ~半導体の冷却要素技術と熱モデル~」と題するセミナーを企画し、高発熱半導体のイネーブルメントに不可欠な低熱抵抗化において重要な要素技術となっている沸騰冷却、TIM 材の一つであるフェイズチェンジマテリアルについて、特別講演としてお話し頂くとともに、半導体構造設計技術 SC／熱設計技術 WG における取り組みなどを紹介させて頂くことと致しました。

つきましては、この機会にぜひご参加頂き、各社の事業戦略・標準化戦略の立案に役立てて頂くとともに、ご興味がございましたら同 SC への参画もご検討頂けますと幸いに存じます。

敬具

【開催概要】

日 時 : 2026 年 3 月 5 日 (木) 13:10~17:00

開催方法 : Webex によるリモート開催

主 催 : 一般社団法人電子情報技術産業協会
半導体標準化専門委員会／半導体システムソリューション技術委員会
半導体構造設計技術サブコミッティ (SC) ／熱設計技術 WG

参 加 費 : 無料

申込方法 : 下記サイトからお申し込みください。

<https://www.jeita.or.jp/form/custom/454/form>

開催日の 1 週間前を目途に、ご登録頂いたメールアドレス宛に Webex への参加用ミーティングリンク情報をご案内致します。

申込期限 : 2026 年 2 月 27 日 (金) までにお申し込みください。

プログラム：

時間	内容
13:10 – 13:20	開会挨拶・趣旨説明 西 剛伺 半導体構造設計技術 SC／熱設計技術 WG 主査
13:20 – 13:40	経済産業省様ご講演 松岡 徹 氏 経済産業省 イノベーション・環境局 国際電気標準課
13:40 – 14:00	先端半導体パッケージング関連活動の紹介 吉田 浩芳 大阪大学 フレキシブル 3D 実装協働研究所 特任研究員
14:00 – 14:50	<特別講演 1> 半導体冷却の限界をどう越えるか — 沸騰冷却とハニカム多孔構造 — (仮) 森 昌司 氏 九州大学 大学院工学研究院機械工学部門熱工学講座 兼 カーボンニュートラル・エネルギー国際研究所 教授
14:50 – 15:20	熱設計技術 WG 活動紹介 西 剛伺、篠田 卓也 半導体構造設計技術 SC／熱設計技術 WG 委員
15:20 – 15:40	休憩
15:40 – 16:20	<特別講演 2> パワー半導体実装における PC-TIM (Phase Change – Thermal Interface Material) の取り扱いについて (仮) 吉渡 新一 氏 富士電機株式会社 半導体事業本部産業事業部産業設計第一部 担当課長
16:20 – 16:40	熱設計技術 WG ・国プロ活動紹介 羽鳥 仁人、武井 春樹 半導体構造設計技術 SC／熱設計技術 WG 委員
16:40 – 16:50	閉会挨拶 西 剛伺 半導体構造設計技術 SC／熱設計技術 WG 主査

※プログラムは、都合により予告なく変更となる場合があります。予めご了承ください。

■運営事務局・各種お問合せ先

一般社団法人電子情報技術産業協会

事業戦略本部 事業推進部 担当：岩渕・遠山

〒100-0004 東京都千代田区大手町1丁目1番3号 大手センタービル 4階

E-mail : device3@jeita.or.jp

■個人情報保護について

※お申込み頂いた皆様の個人情報は、本セミナーの受付をはじめ、JEITA 主催セミナーのご案内、セミナーアンケートでの質疑回答のために使用致します。

これらの目的以外で使用することはございません。

※JEITA の個人情報保護方針につきましては下記をご参照ください。

<http://www.jeita.or.jp/japanese/privacy/>

以 上